



**AVATEC WILL BECOME THE BEST COMPANY
IN THE CURRENT FIELD
WITH CONSTANT CHALLENGES AND INNOVATIONS**

AVATEC은 끊임없는 도전과 혁신으로 현 분야 최고의 기업이 되겠습니다.



DISCLAIMER

본 자료는 투자자 여러분의 이해증진을 위하여 작성된 자료로서 포함된 경영실적 및 재무성과와 관련된 정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관련된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘E’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 예측정보는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 예측 정보에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생 할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임(과실 및 기타 경우 포함)도 부담하지 않음을 알려드리며, 어떠한 경우라도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로써 사용될 수 없습니다.

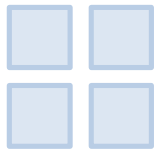


Table of Contents

Ch1. 회사 소개

- 01. 회사 개요
- 02. 회사 연혁
- 03. 사업 영역
- 04. 제품 소개
- 05. '25년 매출 구성
- 06. 향후 매출 계획

Ch2. 성장 사업

- 01. 식각/코팅 사업
- 02. MLCC 사업

CH3. 신규 사업

- 01. TGV Biz. 기술 및 현황
- 02. 박막 Capacitor 기술 및 현황

Ch4. Appendix

- 01. 주주 현황
- 02. 매출 현황
- 03. 요약 재무제표
- 04. 주주 친화정책
- 05. 관계사 현황
- 06. MLCC Line-up
- 07. MLCC 수주 실적 및 전망



Table of Contents

Investor Relations 2025

Chapter1. 회사 소개

- 01. 회사 개요
 - 02. 회사 연혁
 - 03. 사업 영역
 - 04. 제품 소개
 - 05. '25년 매출 구성
 - 06. 향후 매출 계획
-

CH1. 회사 소개

01. 회사 개요

회 사 명	(주)아바텍 (AVATEC Co.,Ltd.)
회 장	위 지 명
대 표	박 명 섭
설 립 일	2000. 09. 01
자 본 금	8,153,750,000원
사업장 현황	대구본사 대 지 : 13,200m² 공 장 : 12,500m² 기숙사 : 1,300m² 구미1공장 대 지 : 26,500m² 공 장 : 30,500m² 오창공장 대 지 : 14,900m² 공 장 : 2,500m²
인 원 현 황	400명 (2025년 10월 기준)
주 소	본사:대구 달서구 달서대로 85길 100 구미1:경북 구미시 산동읍 첨단기업7로 59-21 구미2:경북 구미시 산동읍 하이테크밸리(5산단) 오창:충북 청주시 청원구 오창읍 오창가좌1길 49
Home page	http://www.avatec.co.kr
E-mail	avatecmlcc@avatec.co.kr



오창공장

- 대지 (14,900m²)
- 건축 (2,500m²)



구미2공장

- 대지 (54,328m²)
- 준공 ('26 예정)
- 양산 ('27~ 예정)



구미1공장

- 대지 (26,500m²)
- 건축 (30,500m²)



본사 (대구공장)

- 대지 (13,200m²)
- 건축 (12,500m²)



회사 연혁
**설립 및 성장기**

2000.09~

- '00.09 AVATEC 설립
- '01.12 모니터용 ARAS 코팅유리 양산공급
- '04.05 Projection TV용 코팅유리 공급
- '09.08 PDP TV용 EMI Filter 공급

MLCC 사업 진출

2018.11~

- '18.11 MLCC 투자 (450억원)
- '19.05 MLCC 양산 Line set-up
- '21.03 L社 초기 양산 (IT向)
- '21.09 Global태양광 업체 양산공급
- '23.01 Auto向 해외 공급
- '24.08 L社 양산 공급

MLCC 추가 투자

2023.04~

- 'MLCC 2차 투자 900억원 공시
 - 공장부지 확보 완료
 - 설비 일부 투자 완료
 - 2027년 상반기 투자 완료 예정

Start

2011.09~

LCD Panel Slimming

- '11.09 구미공장 완공
- '11.10 LCD Panel Glass Slimming 공급
- '11.12 유상증자 (3자 배정, LG Display)
- '12.11 코스닥 상장
- '13.01 터치 패널용 강화 Glass 공급



2022.01~

OLED Panel Slimming

- '22.01 OLED Panel Glass Back coating 투자 (100억원)
- '24.01 OLED Panel 식각 및 강화코팅 양산
- 대형 Size (G8.6) OLED 식각 후공정 개발 中



2026.~

신규 사업 진출

- 박막-Capacitor 개발(Non Trench 타입)
- TGV 에칭 Line set-up 예정



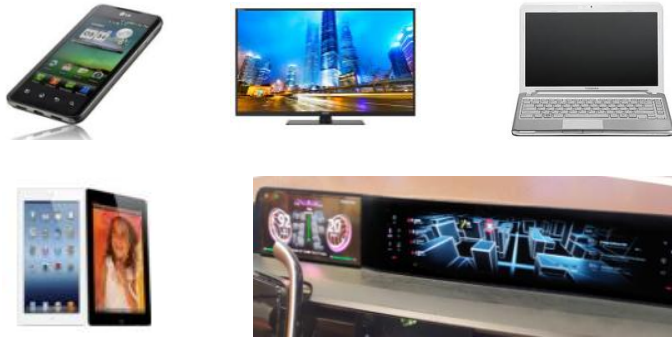
사업영역별 Application



* 신규 사업

- 태블릿 PC와 모바일 기기, 차량용 등 중소형 LCD/OLED 패널의 두께를 얇게 식각하고, 기능성 코팅을 부여.
- 제품의 박형화와 강성을 확보하고, 화질 향상 기능을 부여하는 기술

LCD



<전장용 디스플레이, 출처: LG디스플레이>

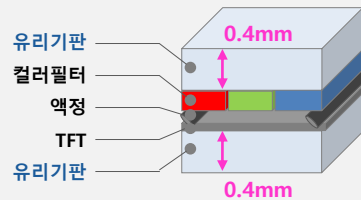
OLED



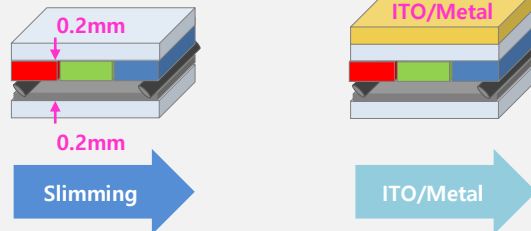
적용
제품

제품
구조

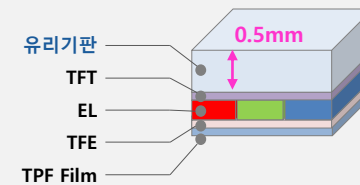
Panel 구조



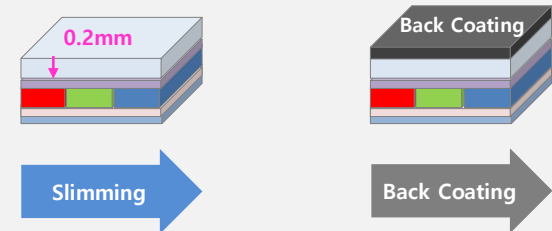
공정 진행 후



Panel 구조



공정 진행 후

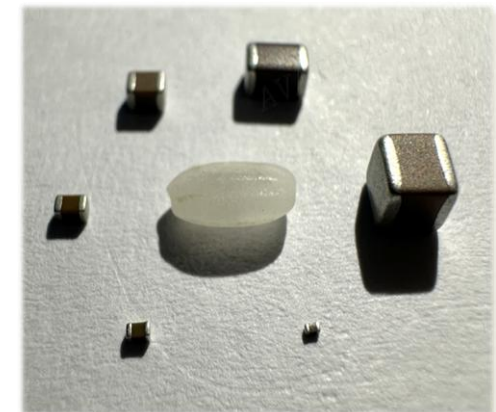
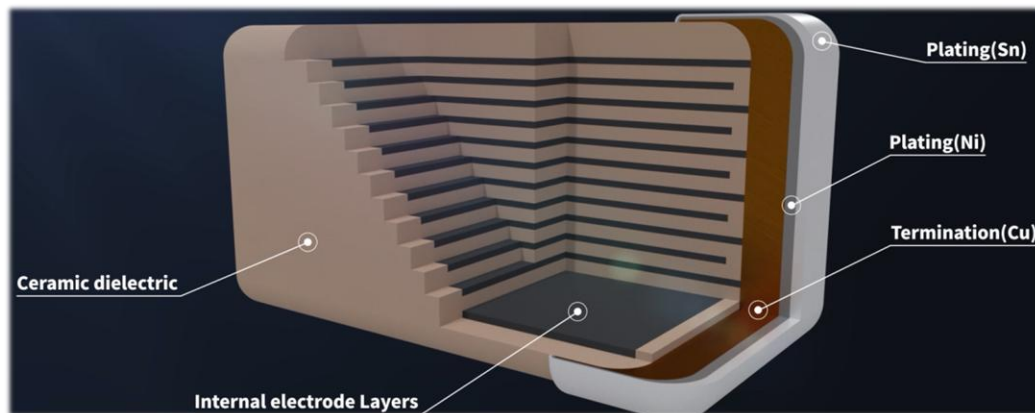


- 다층 세라믹 커패시터 (MLCC)는 휴대전화, PC, FPD 관련기기, 자동차 부품, 통신 부품 등 다양한 분야에 적용
- 전기/전자 회로에서 전류의 흐름을 일정하게 제어하는 부품

적용 제품



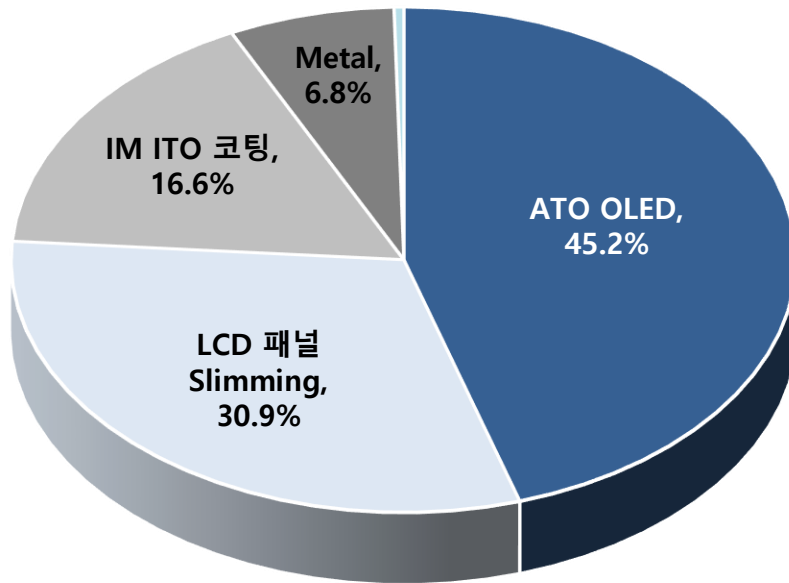
제품 구조



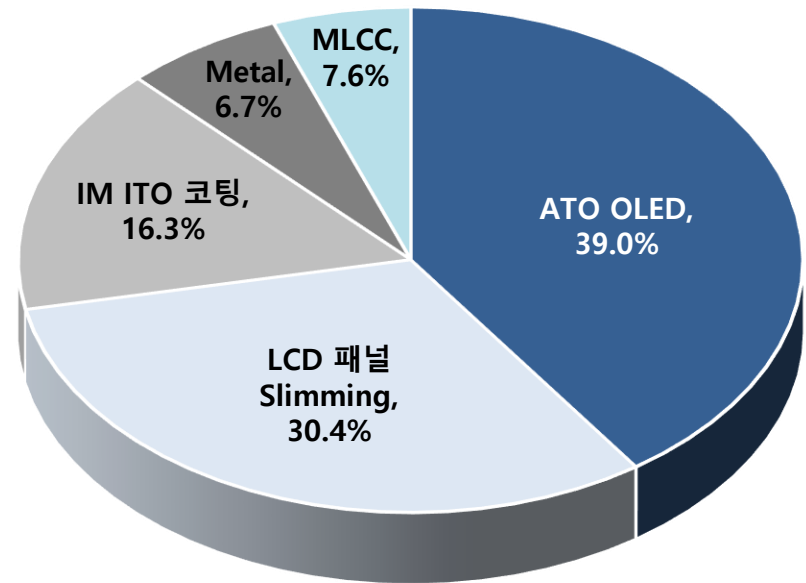
** Size[mm] : 0603~3225

● 식각 사업의 안정적인 매출 구조와, MLCC는 S사에 공급을 재개하고 신규 고객(L1)을 확보

2024년 매출 845억원



2025년 예상 매출 비중(%)



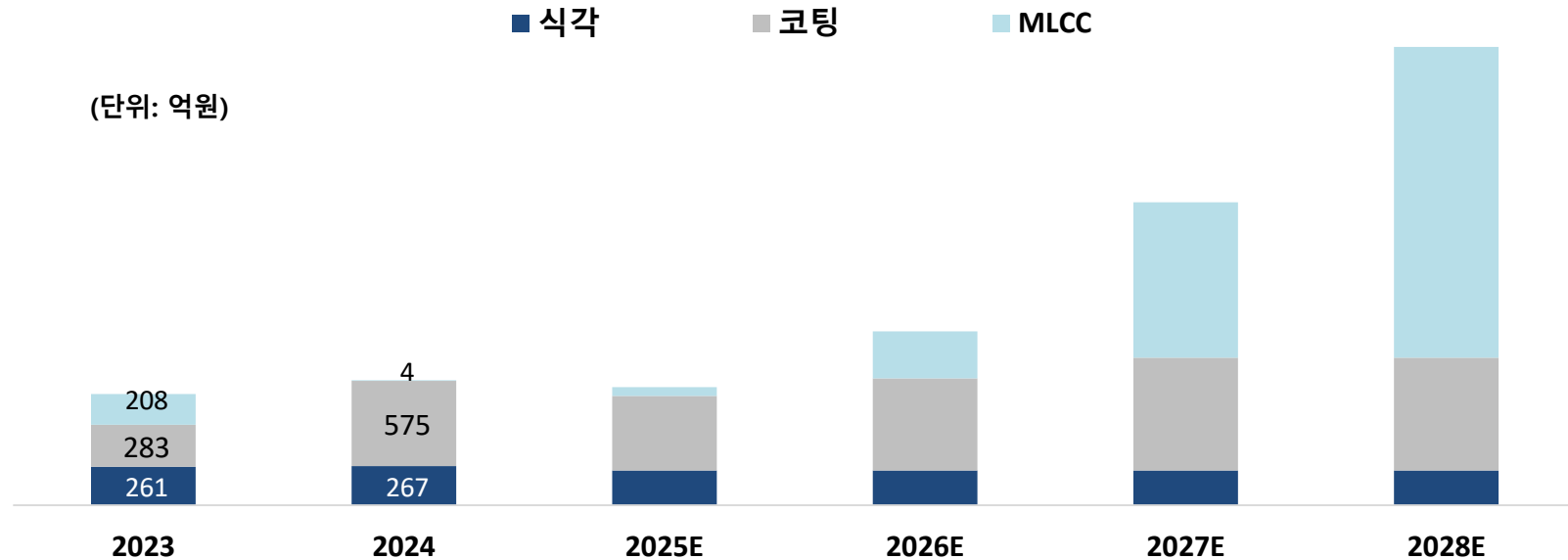
식각/코팅

식각 및 코팅 사업의 안정적인 실적 유지로 꾸준한 현금흐름 창출

MLCC

22년 이후 장기간 영업 활동의 결실로, 26년 이후부터는 매출 성장이 예상됨

● 식각·코팅의 안정적인 CASH-COW를 바탕으로 MLCC의 전장 부분의 지속적 성장 기대



식각/코팅
(CAGR 7%)

- OLED 전환율 확대와 기술 경쟁력 우위로 OLED 코팅·식각 물량 동반 증가
- 우월한 기술 경쟁력 바탕으로 차량용 LCD ITO 코팅 물량 증가 기대

MLCC
(CAGR 170%)

- 국내 IT대기업에 전장/IT용 MLCC 공급 확대
- 글로벌 전장 부품사에 MLCC 양산 공급 추진
- 전략적인 사업 파트너 확보



Table of Contents

Investor Relations 2025

Chapter2. 성장 사업

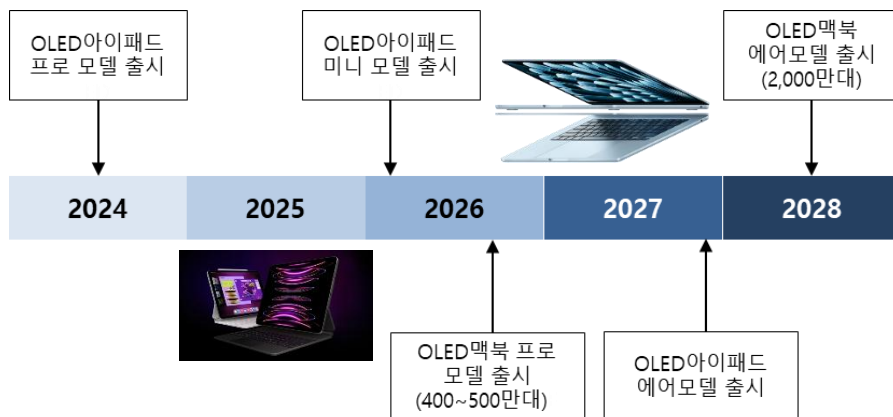
01. 식각/코팅 사업

02. MLCC 사업

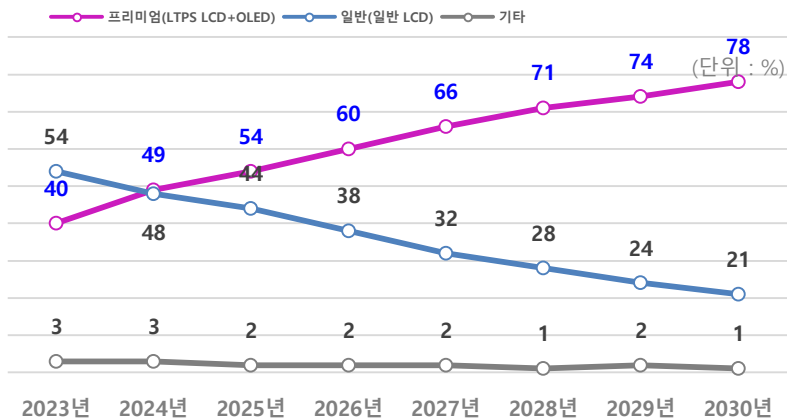
1. 시장 변화와 아바텍 기회 요인

시장의 기회 요인

OLED 전환 로드맵



글로벌 자동차용 디스플레이 시장 패널별 점유율



자료: OMDIA, 메리츠증권 리서치센터

아바텍의 기회 요인

글로벌 IT·전장 OLED 전환 가속

차량용 OLED 비중 40% → 78% 확대

식각~증착 일원화 공정 기술 보유

Hybrid OLED 대응 설비·기술 내재화

신규 코팅/식각 수요 증가 및 매출 성장

고부가가치 공정 확대로 수익성 개선

기술 우위 확보로 고객사 신뢰 강화

기술 진입장벽 확보 및 장기 수익성 확보

2. 신규 ITEM 매출 전망

“OLED 중심 신규 아이템 확대와 건식 코팅 전환으로 실질 매출 성장 가속”

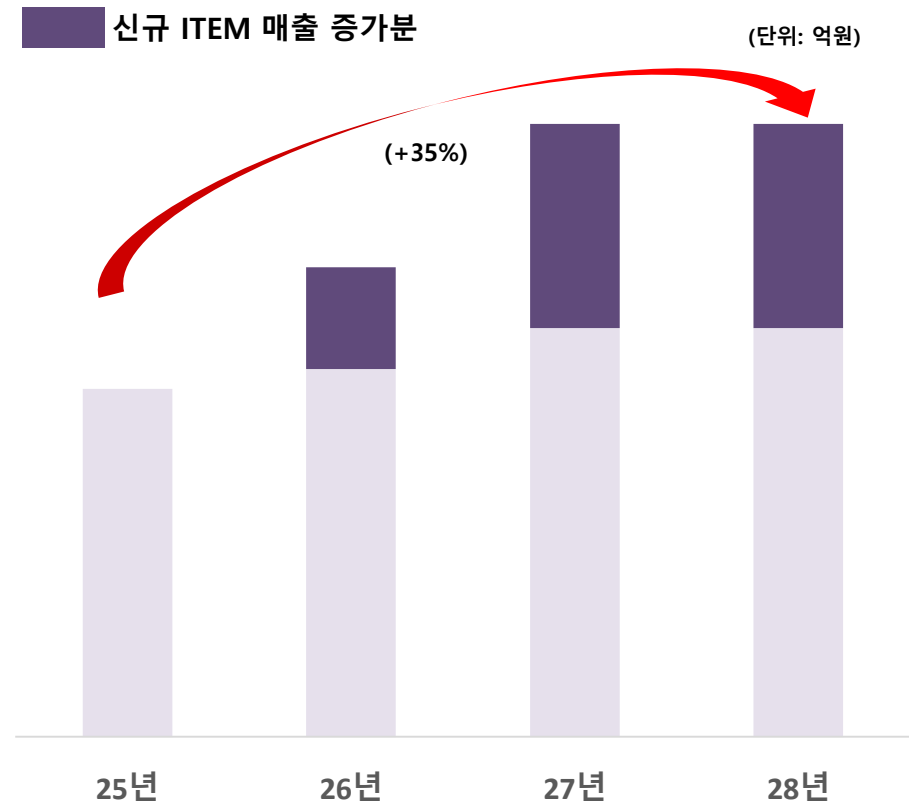
OLED 식각 / Back 코팅 매출 확대

- 26년이후 IT OLED 및 차량용 디스플레이 전환 확대 예상
- 기술/가격 경쟁력 바탕으로 IT OLED 점유율 확대
- 적용 제품군이 노트북, 모니터, 차량용으로 확장 중

LCD ITO 코팅 매출 확대

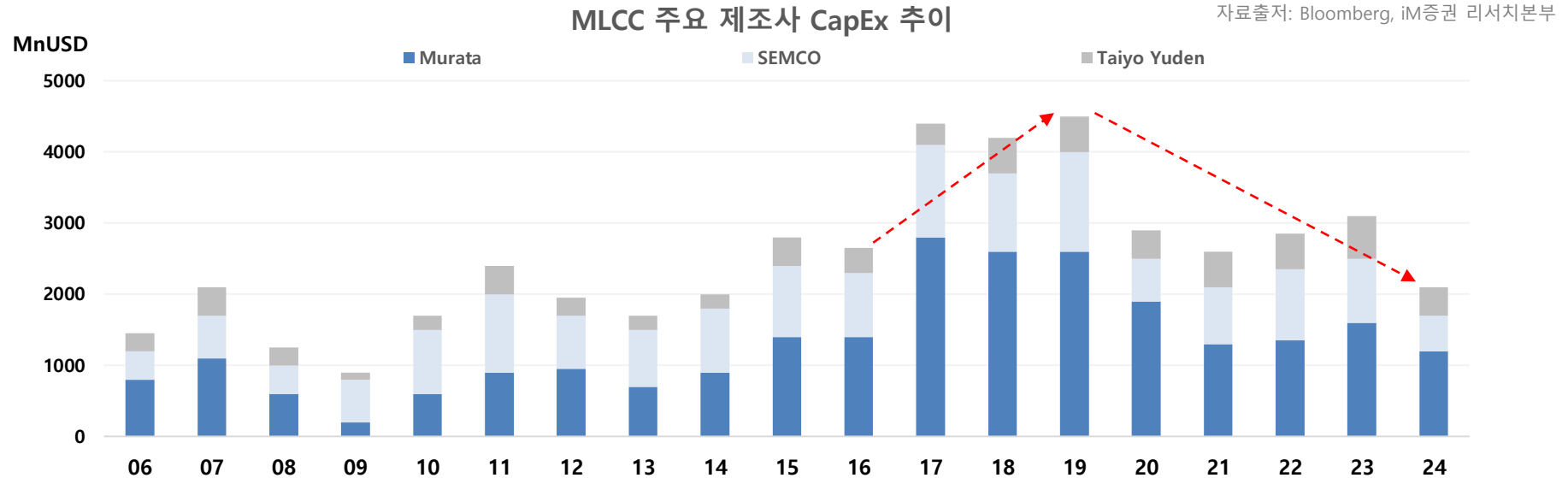
- ITO계 신규 건식 코팅기술 개발 中
기존 습식 코팅품 → 건식 코팅 방식 변경 검토중
- 적용 제품군 확대
IT용 → 차량용
- 건식코팅 확대 적용시 식각 매출 추가 발생 기대

식각 사업부 매출 추이



1. 시장 환경

MLCC 수요 증가와 진입기회 증가



수요 확대

전장 & AI 서버 시장 확대로 수요는 증가하나 공급 재고는 tight 한 상황(2018년 시장 수급 Unbalance 재현 가능)

공급 정체

Major 업체들 2019년 이후 보수적인 투자 기조를 유지함.
▶ High end 기종은 공급 Capa 부족 상황 도달.

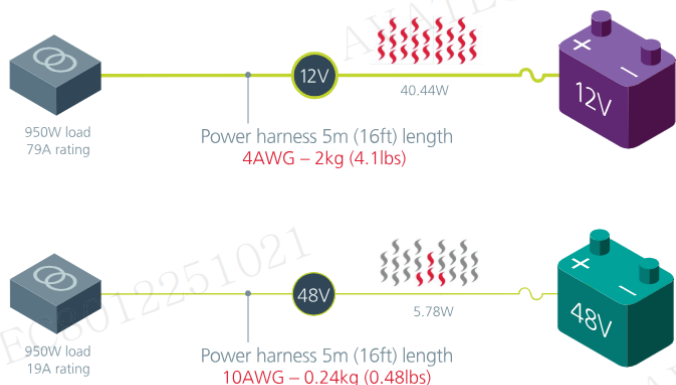
강력한
진입 기회

2. 차별화 경쟁력

“AI & 전장 시장의 12V → 48V system 전환에 따른 MLCC에 요구되는 특성을 구현하는 핵심 기술력 보유”

“산업용 S社에 진입한 핵심 Seed 기술을 기반으로 고용량 고전압 3216 4.7uF 100V Line-up 확장”

12V → 48V system 전환



<https://www.vicorpower.com/resource-library/articles/automotive/48v-systems-goodbye-12v>

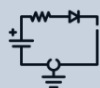
고효율화 Needs → 48V System

48V向 100V Line-up

Seed 기술 (Yellow) 48V system向 고용량 100V 기종 (Blue)

Size	1608							2012							3216							3225						
	6.3	10	16	25	35	50	100	6.3	10	16	25	35	50	100	6.3	10	16	25	35	50	100	6.3	10	16	25	35	50	100
100nF																												
220nF																												
470nF																												
1uF																												
2.2uF																												
4.7uF																												
10uF																												
22uF																												
47uF																												
100uF																												

핵심 Seed 기술



DC-Bias 특성

전압이 걸려도 용량 변화가 거의 없어 회로 안정성 우수



에너지 저손실 특성

발열이 적고 에너지 손실이 적음 → 고 효율 회로 구현



저소음 특성

소음(리플)이 적어 고급 전장용 회로에 적합



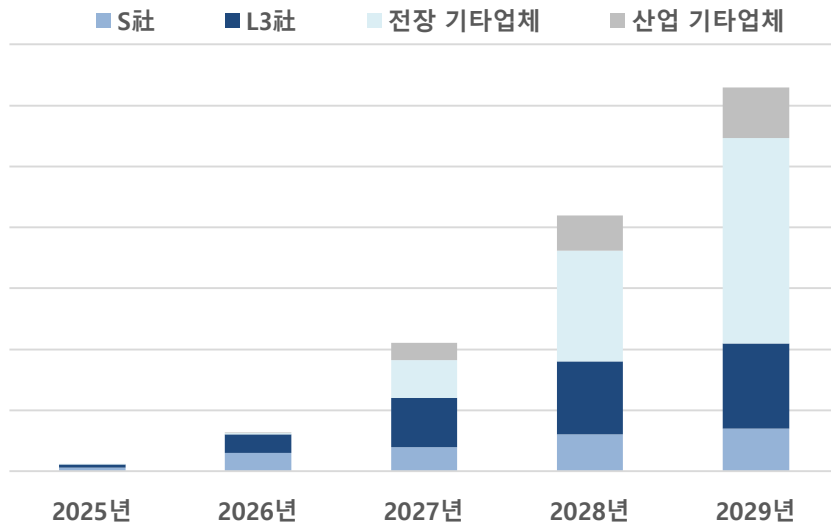
고신뢰성

전장 기준(AEC-Q200)보다 높은 수준의 고신뢰성

3-1. 고객별 영업 전략

MLCC, 29년까지 CAGR 170% 증가 전망

매출전망



S社	양산 공급	
L社	L1	양산 공급
	L2,3	양산 승인 → 양산 공급
전자	Tier2	양산 승인 → 양산 공급
	Tier1	양산 승인 → 양산 공급
	글로벌	양산 승인 → 양산 공급
산업	글로벌	양산 승인 → 양산 공급

주요 고객 커버리지 확대 전략

L3社



❶ L社 집중 영업 프로모션

- L1 IT 및 전장용 50여 품목 인증. 생산 단계로 확장 중
- L2,3 카메라 모듈, ADAS, ECU 등 전원회로용 MLCC 공급 확대

전자업체



❶ 전장 제품군 확대

- 고부가가치 X7R 고용량 라인업 강화로 수익성 극대화
- 적용 어플리케이션 확대
Comfort → Safety / Powertrain

산업업체



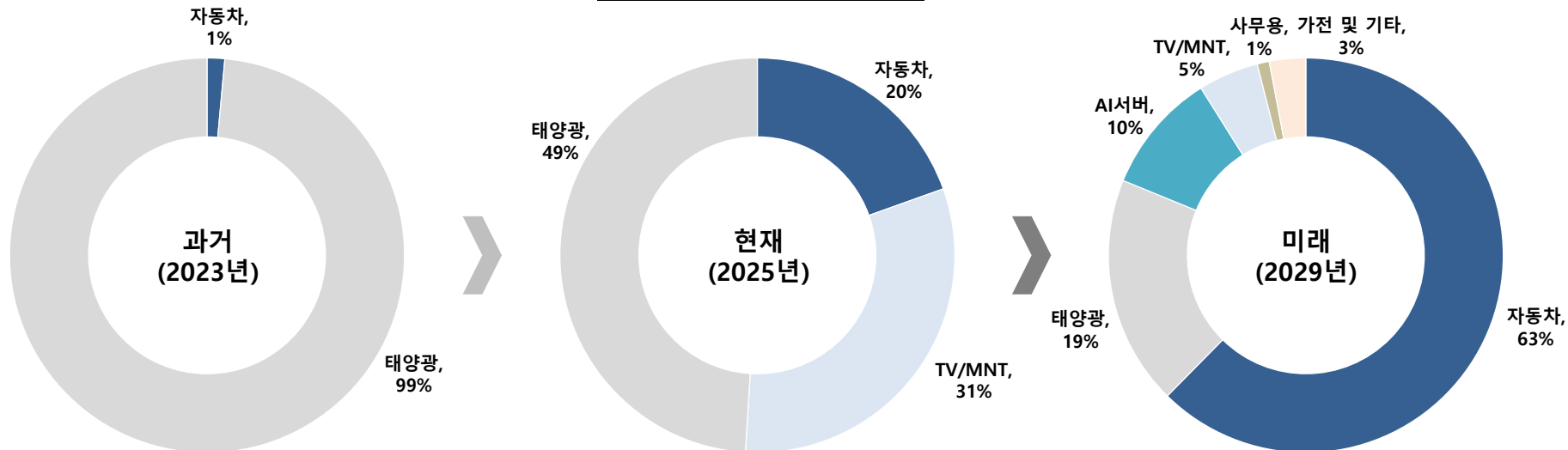
❶ 적용 어플리케이션 확대

- PV 인버터 → ESS, 전력제어보드, EV 충전기용 MLCC 공급 확대
- 고전압·고신뢰 AI 서버 시장 진입

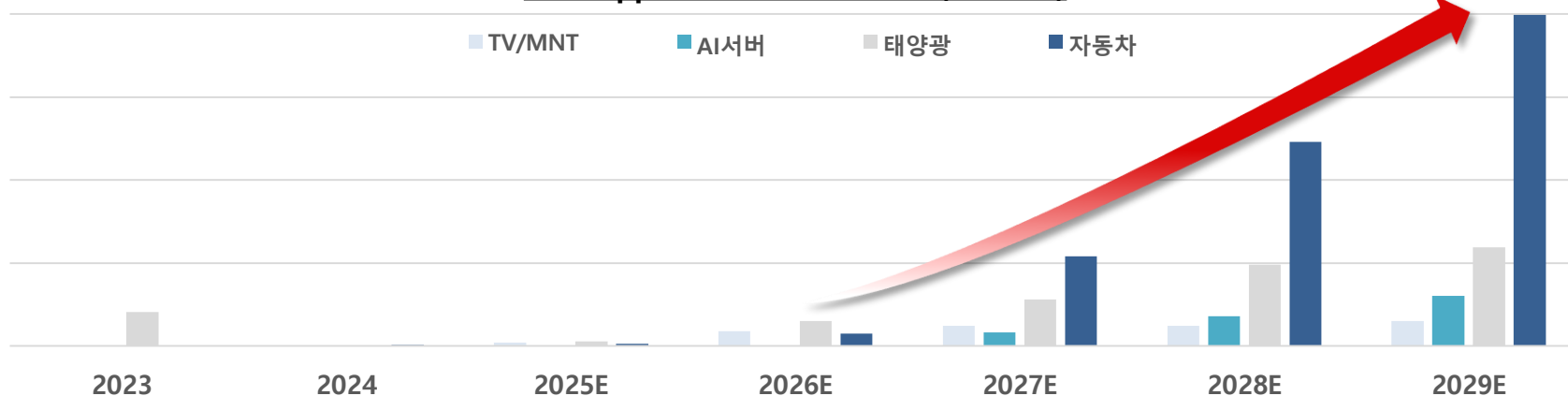
3-2. 제품별 영업 방향

산업용 태양광 중심구조에서 전장 및 AI서버 시장으로 영역 확장

AVATEC's Transformation



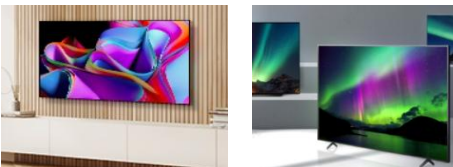
주요 Application별 매출 변화 ('23~'29)



4-1. Promotion 현황 (L3社 업체)

IT / 가전 분야

▶ Notebook, Tablet, OLED TV, 가전 등



▶ L1社

- 전제품군 메인 기종 공급 중
(Notebook용 → Monitor / TV 용 제품 확대)

▶ L2社 / L3社

- TV용 통신모듈 개발 제안

▶ L1社

- 기술력 / 품질력 기반 제품별 메인기종 점유율 확대

▶ L2社 / L3社

- TV용 통신모듈 개발 완료 및 양산승인 (26년 4Q~)
- 26년 이후 고객 제품군 내 점유율 상승

전장부품 분야

▶ 전장용 부품 (IVI, ADAS, ECU, 전동화 부품)



▶ L1社

- 전장용 Display용 품목 양산공급 (25년 1Q~)
- 저소음 MLCC 공급으로 고객Needs 대응

▶ L2社 / L3社

- 고 신뢰성 MLCC 적용으로 전장 규격 대응력 강화
- 전장부품 공급 이력 기반, 개발 제안

▶ L1社

- 전장용 양산이력 다수 확보 후, 신뢰성 있는 공급사로 자리매김

▶ L2社 / L3社

- 고부가 제품 대응력 확보 및 시장진입 (27년 1Q~)
(전동화부품, ADAS, BMS 등)

적용 제품

사업 현황

전망 및 계획

4-2. Promotion 현황 (전자업체)

국내 자동차부품 분야

▶ Comfort 전동화 부품



- ▶ 파워윈도우 제조사 (L社) : 양산 대응 중 (21년 1Q~)
- ▶ PTC 히터 제조사 (W社) : 양산 대응 중 (21년 1Q~)
- ▶ 충전 부품 제조사 (U社) : 초도 양산 이력 확보 (21년 3Q~)
- ▶ 조향 제어 시스템 제조사(K社) : 양산 공급 진행 중 (25년 2Q~)
- ▶ 헤드램프/충전기 제조사 (S社) : 양산 공급 진행 중 (25년 3Q~)

- ▶ 전장용 부품 공급 및 품질 안정성 인증을 통한 신뢰도 확보
- ▶ 고객사 성장방향인 자율주행 및 전동화용 부품 확판 기회 확보
 - Comfort 분야 → Safety & ADAS 및 Power train 분야
- ▶ 무선 충전기 외 Built in CAM, Mood Lamp 제품군 확판
- ▶ 확판 고객 : M社, HM社, MD社, Y社, P社, H社

글로벌 자동차부품 분야

▶ ECM, USV, 자율주행 및 전동화 부품



- ▶ '25년 2Q ~ 대상기종 검토 (글로벌 전장부품 제조 V社)
- ▶ '25년 2Q 업체 등록 후, 주력기종 검토 및 견적 제출 (전장 음향기기 제조 H社)

- ▶ 글로벌 전장 및 음향기기 업체 공급 시점 : 26년 2Q~
- ▶ 초기 공급 후 지속적인 고객만족 활동으로 확판 기회 확보
- ▶ 글로벌 전기차 선두업체로의 양산적용 이력 확보
- ▶ 확판 고객 : V社, L社, Z社, D社, H社

적용 제품

사업 현황

전망 및 계획

4-3. Promotion 현황 (산업용 업체)

태양광 발전소 · 산업용 인버터 분야

▶ 태양광 발전용 Power Optimizer, Inverter



▶ Power Optimizer (S社)

- 2021년~양산공급
- 시장상황(고금리)&유럽시장 재고과잉으로 출하량 감소('23년2H~)
- 재고 감소 및 시장 회복에 따른 신규 수주 확보('25년 3Q~)

▶ Inverter (M社)

- 25년 1Q~ 초도양산 공급

- ▶ 글로벌 태양광 설치 증가에 따른 안정적 수요유지
- ▶ 친환경 충전 연계형 시장에서 MLCC 채택 확대 기대
- ▶ 우수한 품질 경쟁력 확보로 Inverter 시장 공급 기회 확보
- ▶ 신규 모델 확대 및 양산 본격화

산업용 분야

▶ 전원공급장치, Lighting Solution, AI서버



▶ 전원공급(D社)

- 현지 바이어 샘플 평가 및 승인프로세스 협의 중

▶ Lighting Solution (A社)

- '25년 1Q : Supplier Pool 등록
- '25년 2Q : 주력 모델 대응용 기종 검토 및 견적 제출

- ▶ 산업용 전원장비 및 조명기기 시장의 경기 회복세에 따른 수요확대
- ▶ 고신뢰, 고내압 MLCC 적용 증가 (AI서버 적용군)
- ▶ 품질경쟁력 기반 국내외 신규공급선 진입기회 증대
- ▶ 적용 어플리케이션 (ESS, 전력제어보드, EV 충전기용)확대
- ▶ 확판 고객 : F社, T社, L社, S社, A社

적용 제품

사업 현황

전망 및 계획

5. 라인 증설 계획 및 마케팅 타겟 기업

CAPA 증설 확보로 증장기 성장기반 조성

■ MLCC 라인 증설 투자

Capa. 3216 size 기준

	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
라인수	1	1	3	6	9
Capa/月 (억개)	1.6	1.6	4.8	9.6	14.4

■ Marketing Target 기업

IT/산업용	국내	 LG Display  LG Electronics  LG Innotek  SAMSUNG  SK hynix
	해외	 solar edge  SHARP flex  Acuity Brands  SMA  MA Solar  DELTA
전장용	국내	 LG Display  SL Corporation  LG Innotek  myunghwa  PHC  HANSOL MOBILITY  HYUNDAI  KC INDUSTRIAL  WIDOR  LS Automotive  HYUNDAI MOBIS  Mando  YURA  KIA
	해외	 SMR  JABIL  HARMAN  LEAR CORPORATION  Valeo  LG-MAGNA  ZF GROUP  DENSO  CRAFTING THE CORE  MOTHERSON  BOSCH  gm  Mercedes-Benz  BMW  TESLA



Table of Contents

Investor Relations 2025

Chapter3. 신규 사업

01. TGV Biz. 기술 및 현황

02. 박막 Capacitor 기술 및 현황

개발 배경

TGV (Through Glass Via) 기술 개발 동향 및 차세대 수요 배경

반도체 패키징 시장의 고집적에 대응하기 위한 차세대 고신뢰성 유리기판 기술 확보하여 AI·서버용 시장 진입

■ TGV 개발동향

- ▶ 유리기판은 기존에 쓰였던 플라스틱 기판의 유기 소재 대비 전력 효율성, 열과 휘어짐에도 내구성이 강한 장점으로 반도체 성능을 향상, 대면적화 가능
- ▶ 유리 기판이 주목받는 것은 AI의 급격한 확산 때문"이며 "이르면 2026년부터 인텔, 엔비디아, AMD 등 고성능 컴퓨팅(HPC) 업체들은 AI 데이터 처리량의 기하급수적 증가에 대응하기 위해 유리기판 채용에 나설 것으로 전망된다"고 예상

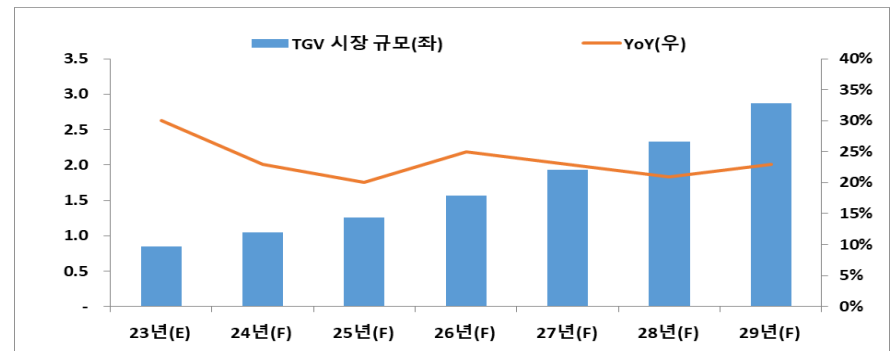
■ TGV 유리기판 장점

고밀도 Interconnect	복잡한 설계와 효율적 공간 활용 가능
우수한 전기적 특성	저손실·고전압으로 고속 응용에 적합
낮은 열팽창 계수	열 스트레스 최소화로 안정적 연결
높은 내화학성	화학·환경적 열화에 강함
환경 친화적	재활용 가능, 유해 부산물 최소화

■ 인터포저 비교

구분	TSV (Through Silicon Via)	TGV (Through Glass Via)
도식도	① Micro Bump(< 50μm) ② Bump(50~200μm) ③ PKG Ball(200~300μm)	① Micro Bump(< 50μm) ② PKG Ball(200~300μm)

■ 시장 규모 및 성장성 전망



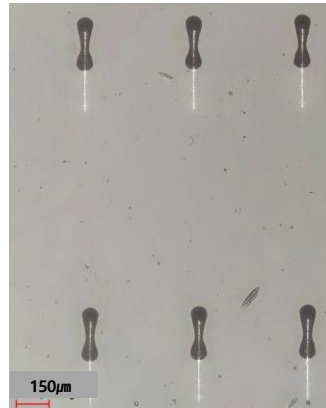
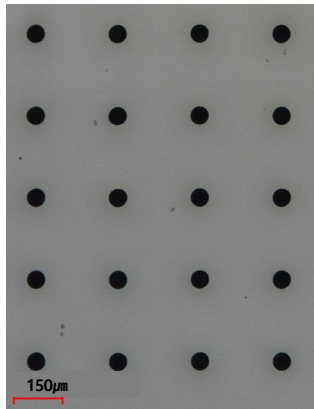
<글로벌 TGV시장전망, 출처: KDB미래전략연구소 산업기술리서치센터>

개발 현황

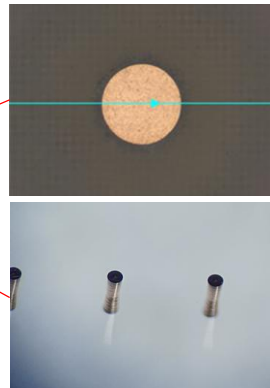
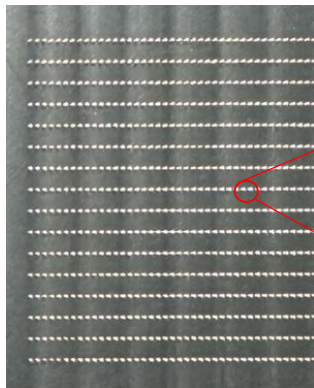
공정 평가

단위 공정별 평가

레이저
및
식각

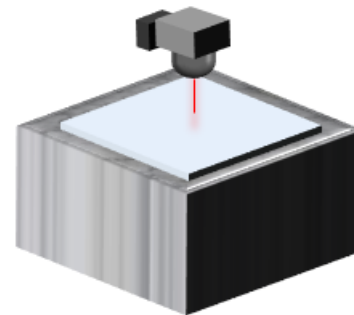


도금
및
연마



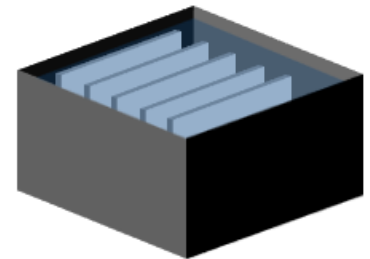
인프라/보유기술

레이저 기술



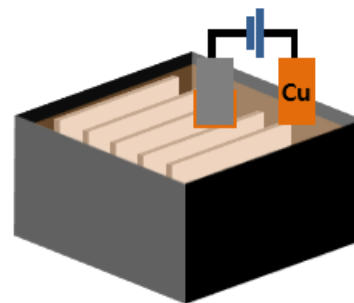
Laser Modification 제어 기술
Via Hole Taper 제어 기술

식각 기술



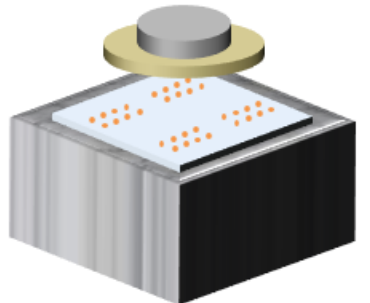
홀 내부 파티클&평탄도 관리

도금 기술



Via Hole 내 균일 도금

연마 기술



표면 Roughness 제어기술
미세 Polishing 기술

향후 계획

선행개발에서 양산·고성장으로 이어지는 TGV 유리기판 비전

■ Roadmap



Step1. 선행개발 완료('25년 ~ '26년)

▶ 식각 공정 개발완료 및 설비 투자

- ① 신규 TGV 공정 개발 및 양산 기반 확보
- ② 510*515 TGV기판용 설비투자 ('25년 4Q)
- ③ 협력 외주 공정 체계 확립

Step2. 준양산 공정구축 및 고객평가(~ '28년)

▶ 초도양산 및 개발승인 병행 대응

- ① 초도양산 개시 및 고객사 인증 병행 추진
- ② 생산라인 안정화 및 수율개선 진행
- ③ 파트너사 협업 통한 공정 신뢰성 확보
- ④ 고객샘플 대응 및 개발승인확대(월 1천장 수준)

Step3. Capa 확충 및 양산확대(~ '30년)

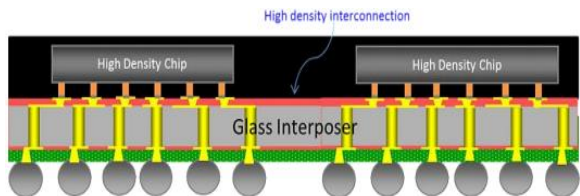
▶ 수요 확대 및 기술경쟁력 기반 고성장 진입

- ① 단계적 생산능력 확충(1차, 2차)
- ② 고객 다변화 및 글로벌 시장진입 본격화
- ③ 월 1만장 이상 생산체계 확보

■ 타겟팅 시장

반도체 패키징용 유리기판

- 패키징 산업의 미세화 및 고주파 / AI 칩 증가로 인터커넥트 기술 수요 증가



산업용, 전력기기용 유리기판

- 고신뢰성 품질 기반으로 산업용 전력모듈, 조명/인버터 장치에 대면적 유리기판 적용 가능성이 상승

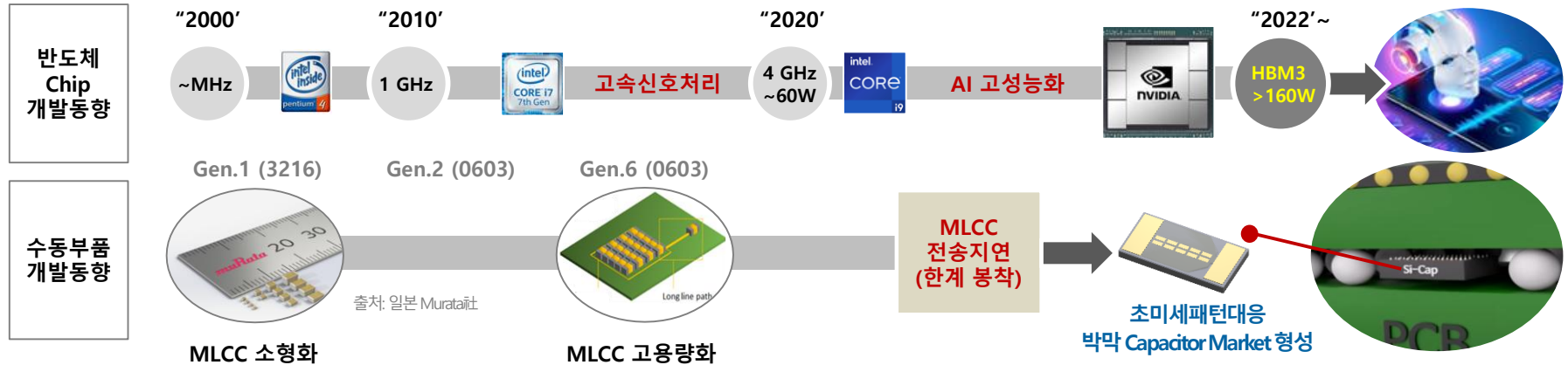


개발 배경

박막 Capacitor 기술 개발 동향 및 차세대 수요 배경

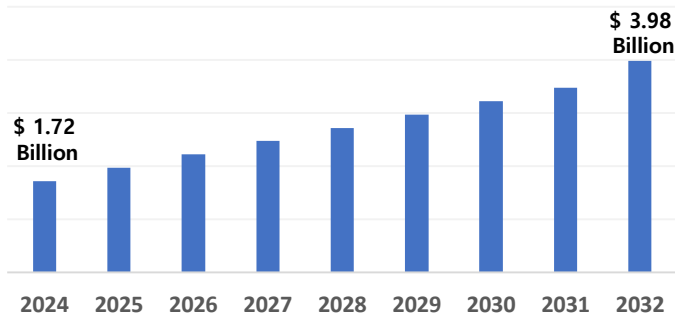
기존 MLCC는 고주파·고용량 구동 시 발열·용량 손실, 전송지연 등 한계가 존재하며, 차세대 AI·HBM 반도체에는 박막 Capacitor의 고용량, 초슬림, 고신뢰성 특성이 필수적임

Capacitor 개발동향 ("2000' ~ 현재)



시장 규모 및 성장성 전망

Global Silicon Capacitor Market



11.5%

CAGR from 2026 to 2032

Source : www.verifiedmarketresearch.com

업계 동향



<https://corporate.murata.com/en-us/newsroom/news/company/general/2023/0308>



<https://www.sedaily.com/NewsView/2GV70QJ8J7>

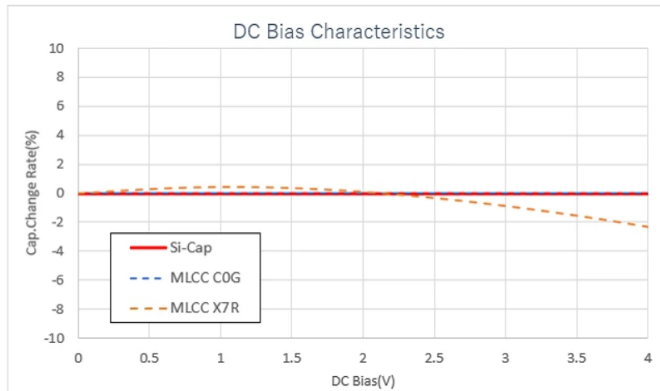
- 1) Murata, 프랑스 캉 지역, 200mm 실리콘 커패시터 생산 라인 확장
- 2) 삼성전기 : 실리콘 커패시터 스마트폰 첫 대량 공급, AI 가속기용 제품 양산

개발 목표

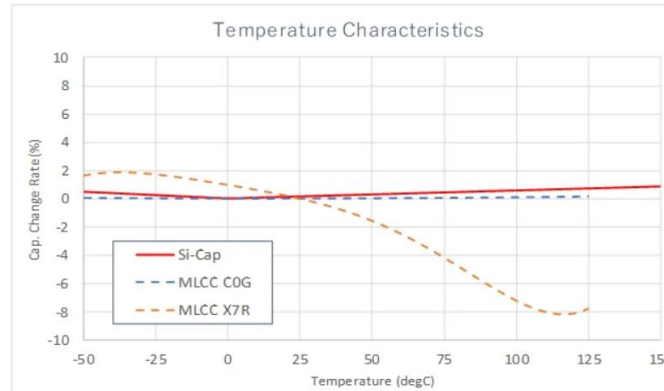
대면적 Non-Trench 박막 Capacitor 개발

■ Si Capacitor 특징

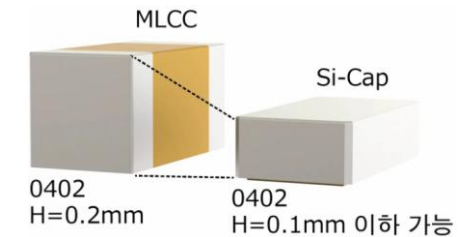
신뢰성 (전압 변화에 따른 용량 안정화)



안정성 (넓은 온도 범위에서도 일정 정전용량 유지)



초슬림화 (패키징내 실장가능)



<출처: <https://techweb.rohm.co.kr/product/passive-components/capacitors/23874/>>

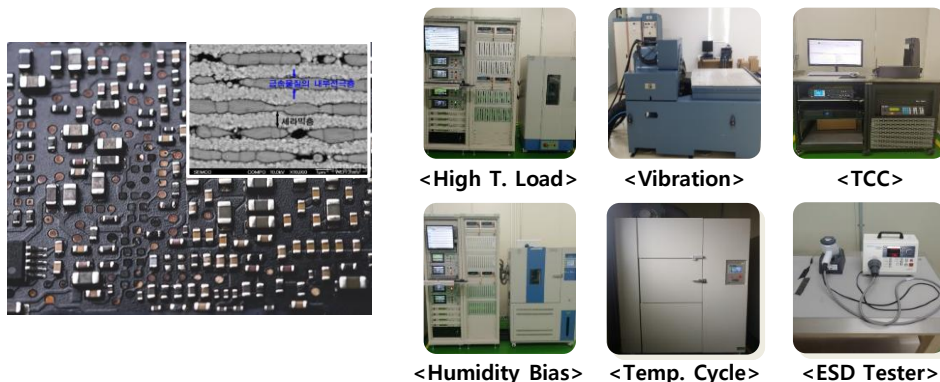
■ Capacitor 구조 별 특징

구분	MLCC	Si 박막 Cap. (Trench type)	박막 Cap. (Non-Trench type)
제품 구조			
특징	- 제품 두께 초슬림화 한계 - 고주파 구동 시 ESR 상승 → 발열 및 용량 손실 증가 - 고속·고전력 반도체용 전원 안정성 확보 한계	- 고종횡비 Trench 형성시 식각 (Deep RIE) & ALD 공정 복잡성으로 인한 비용 상승 - 대면적 기판 적용 제한, 장비투자비 ↑ → 공정 단가 상승, 양산성 확보 어려움	- 수직 적층을 통해 고용량 구현 - In-line 박막코팅 기술 및 장비 활용 - 대면적 코팅 기반의 가격 경쟁력

사내 보유 인프라 및 사업화 전략

개발 인프라/보유기술

MLCC 평가 인프라



Non-Trench Capacitor용 박막 증착 기술 (In-Line Sputtering)

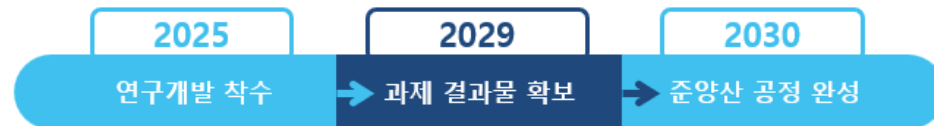
- ① 유전체 및 전극층의 균일한 박막 형성 가능
- ② 고신뢰성 커패시터 공정 기반 기술 확보



< 보유 In-Line 스퍼터링 >

사업화 전략

Roadmap



Step1. R&D 국책과제 수행 ('25년 ~ '29년)

▶ 유전소재 개발 및 다층막 공정 개발

- ① 박막 Capacitor 제조/평가 인프라 구축
- ② 차세대 유리기판 공정 & 양산 기술 확보

* 협력기관 : KICET (한국세라믹기술원)

Step2. 양산 안정화 ('30년 ~)

▶ 인프라 활용 양산 진입 및 안정화

- ① MLCC 성능 인증 경험 활용
- ② 패키지 실장 적용 기술 검증

타겟팅 시장

박막 커패시터 용량/제품군 다변화

- 고객사 맞춤형 용량군 다변화(수직적층형 구조 장점 활용)
- 실장방식에 따른 제품군 확립 (Murata社 벤치마킹)





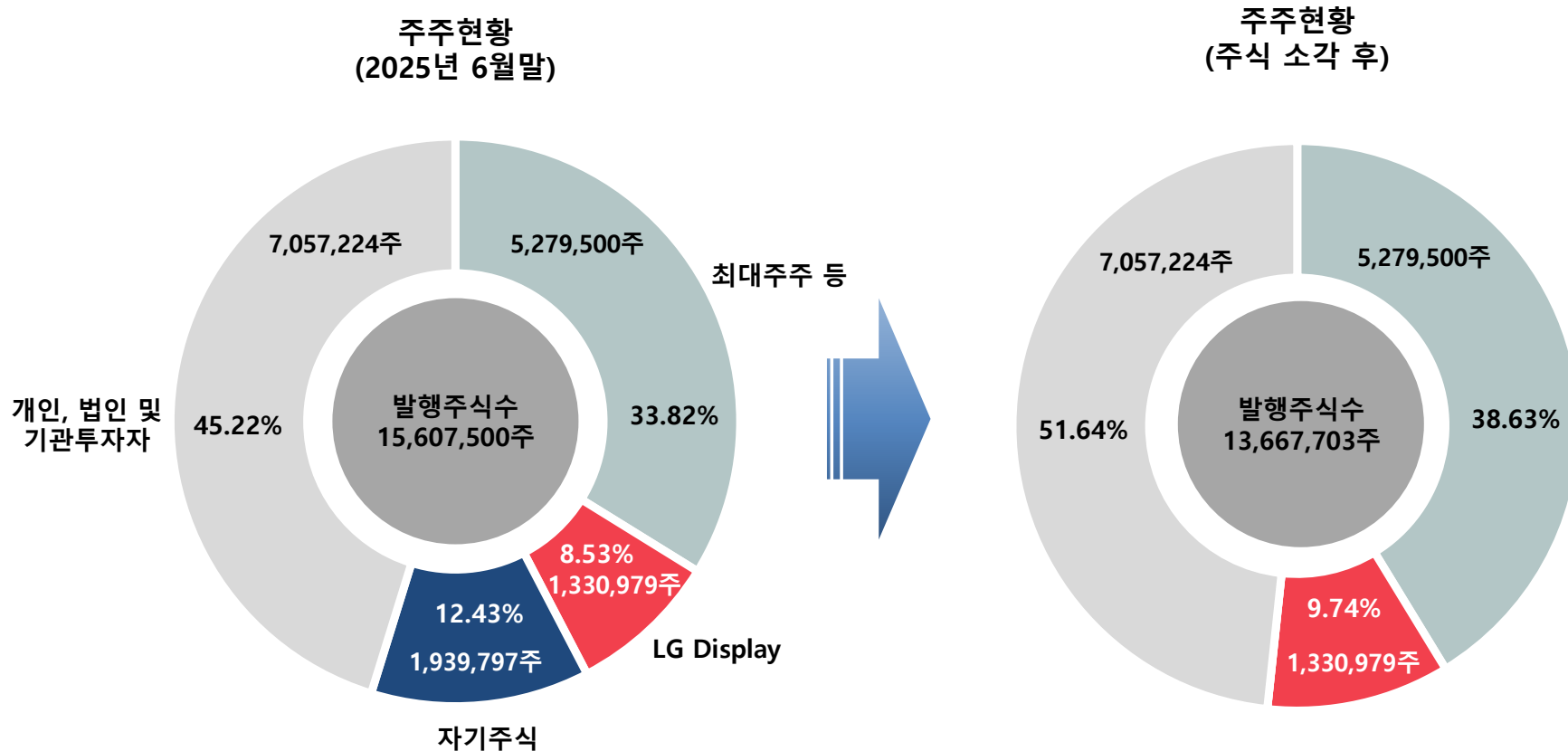
Table of Contents

Investor Relations 2025

Chapter4. Appendix

- 01. 주주 현황
 - 02. 매출 현황
 - 03. 요약 재무제표
 - 04. 주주 친화정책
 - 05. 관계사 현황
 - 06. MLCC Line-up
 - 07. MLCC 수주 실적 및 전망
-

주주 현황



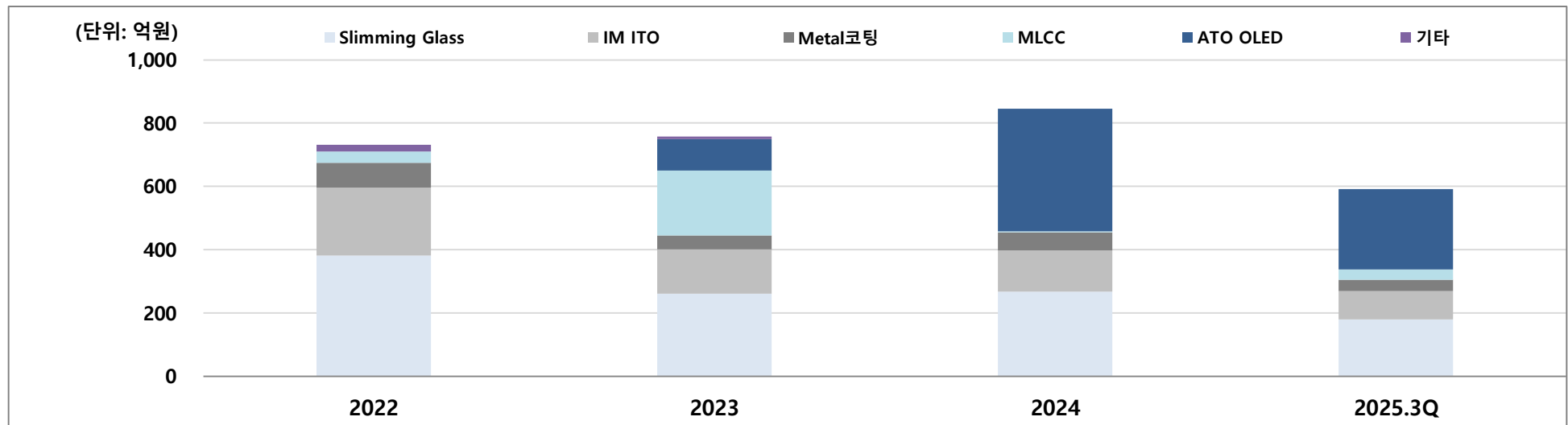
※ 2016년 4월 08일 자사주 700,000주 소각

2025년 9월 22일 자사주 1,939,797주 전량 주식 소각 결정

 매출 현황

(단위: 억원)

구분	2022	2023	2024	2025.3Q
Slimming	382	261	267	-
IM ITO	214	140	131	-
Metal	79	44	57	-
MLCC	35	205	3	-
ATO OLED	-	99	387	-
기 타	21	8	-	-
합 계	731	757	845	592
영업이익	-53	22	58	35
영업이익률(%)	-7.25%	2.90%	6.86%	5.91%



 요약 재무제표

(단위: 억원)

재무상태표

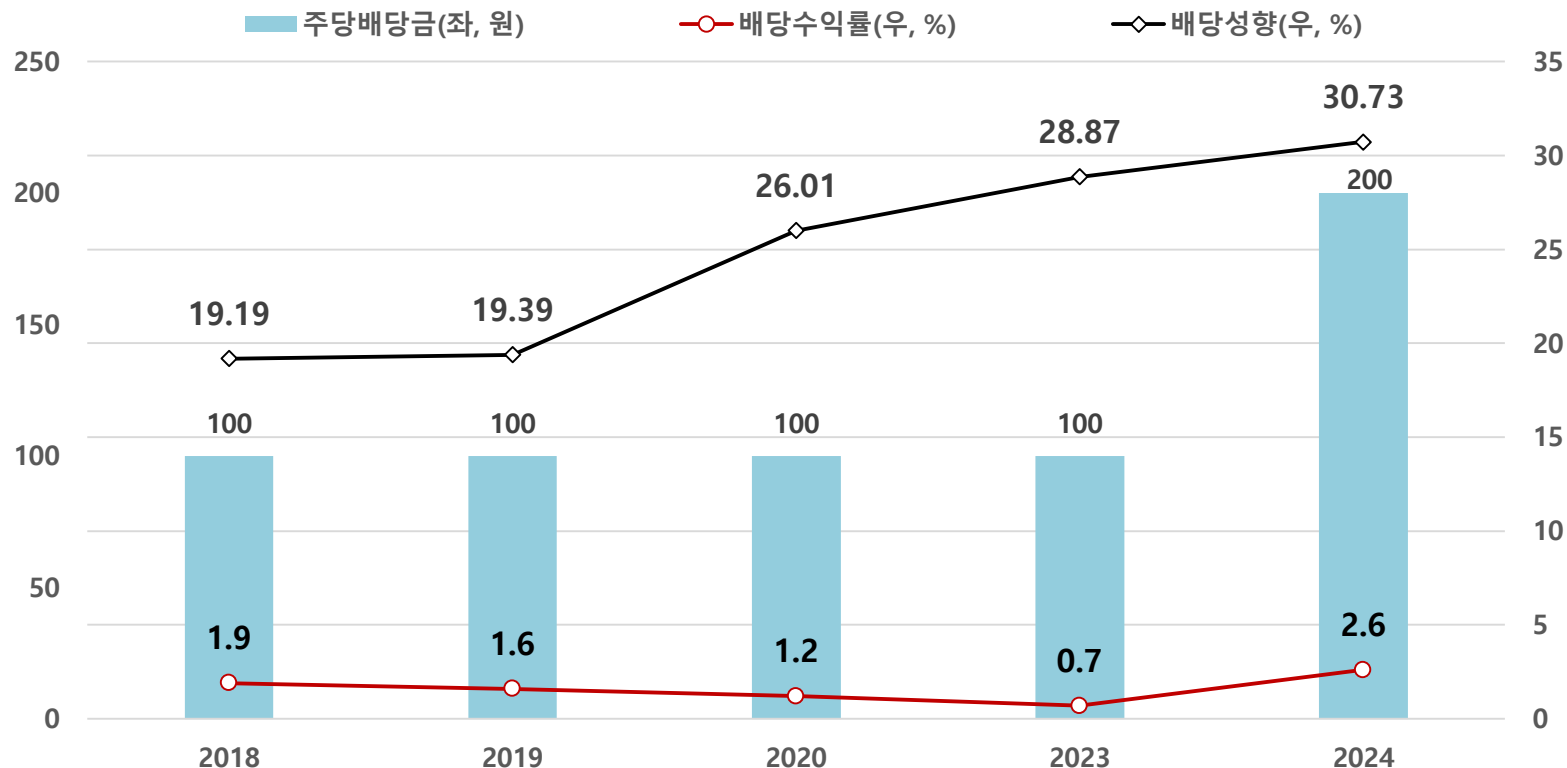
구분	2022	2023	2024	2025.1H
회계기준	K-IFRS			
유동자산	563	555	646	612
(현금성자산)	(111)	(391)	(491)	(414)
비유동자산	935	947	900	929
자산총계	1,498	1,502	1,546	1,541
유동부채	128	74	90	85
비유동부채	3	4	4	4
부채총계	131	78	94	89
자본금	81	81	81	81
자본잉여금	332	332	332	332
자본조정	-146	-146	-173	-172
기타포괄	31	45	27	28
이익잉여금	1,069	1,112	1,184	1,182
자본총계	1,367	1,424	1,452	1,452
자본과 부채총계	1,498	1,502	1,546	1,541

(단위: 억원)

손익계산서

구분	2022	2023	2024	2025.3Q
회계기준	K-IFRS			
매출액	731	757	845	592
매출원가	720	684	726	-
매출총이익	11	73	119	
판관비	65	51	61	-
영업이익	-53	22	58	35
기타수익	1	2	5	-
기타비용	14	1	-	-
금융수익	20	34	21	-
금융비용	1	3	-	-
법인세차감전 순이익	-47	54	84	50
당기순이익	-43	48	89	42

주주 친화정책을 통한 주주가치 제고



주주가치 제고를 위한 노력

- 배당정책 지속 ➡ 주주친화적 배당 정책 실현
- 지속적인 배당성향 증가를 통해 주주환원 의지 실현
- 2025년 9월 자사주 1,939,797주 전량 주식 소각 결정

● 설비 자동화 기술 기반으로 생산 설비의 성능 및 효율성 극대화 기대



■ 양산 가능 모델 | 전 제품 Soft termination 지원 가능

[illegible]

 X5R/X6S Series Line-up

 양산 가능 모델 | 전 제품 Soft termination 지원 가능

Size	0603						1005								1608								2012								3216								3225							
Cap Vdc	6.3	10	16	25	35	50	6.3	10	16	25	35	50	100	6.3	10	16	25	35	50	100	6.3	10	16	25	35	50	100	6.3	10	16	25	35	50	100	6.3	10	16	25	35	50	100					
2.2nF																																														
10nF																																														
22nF																																														
47nF																																														
100nF																																														
220nF																																														
470nF																																														
1uF																																														
2.2uF																																														
3.9uF																																														
4.7uF																																														
10uF																																														
20uF																																														
22uF																																														
47uF																																														
100uF																																														

제품별 수주 실적 및 전망

구분																
	'21		'22		'23		'24		'25		'26		'27		'28	
	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H
L 3社	IT Device (Notebook, MNT, Tablet etc.)															
	차량 Display, Navigation															
	가전 TV															
	통신 Module, 광학솔루션 etc.															
전장	PTC Heater, Power Window Switch															
	Inside/Outside Mirror System, Lamp System															
	무선 충전기, OBC etc.															
	Shift By Wire, Electric Oil Pump, 히터 제어 ECU, ADAS etc.															
산업	태양광 파워 옵티마이저															
	인버터															
	Lighting 솔루션, 전원공급장치															
	AI Server, IoT 센서 허브, TPU etc.															